

第 36 回 レーザ協会セミナー

「ここまで来た！ 躍進するレーザ加工技術」

～次世代を担う実践技術の最新動向～

日時:平成 24 年 11 月 9 日(金)10 時～17 時

会場:埼玉大学東京ステーションカレッジ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12 JR サピアタワー9 階

JR 東京駅・日本橋口直結, 東京メトロ大手町駅・B7 出入口直結

<https://www.bispot.jp/sapia/access/index.html>



プログラム:

10:00-10:10 開会挨拶

＜午前の部＞

10:10～10:55 海外のレーザ加工技術動向ードイツのレーザ加工情報ー

(株)最新レーザ技術研究センター 峯名 宗春

11:00～11:45 ファイバーレーザによる切断加工ーアマダの取り組みー

(株)アマダ レーザ発振器開発部 石黒 宏明

11:50～12:35 高出力レーザ加工の実用化と今後の展開

三菱重工(株) 技術統括本部 先進技術研究センター 石出 孝

＜午後の部＞

13:35～14:20 自動車分野でのトヨタにおけるレーザ適用

トヨタ自動車(株) 生技開発部 佐藤 彰生

14:25～15:05 超精密レーザ加工システムの開発

ナガセインテグレックス 内田 聖一

15:10～15:55 プリント基板穴あけの最新技術動向

三菱電機(株) 名古屋製作所 レーザ製造部 黒澤 満樹

16:00～16:45 レーザによるシリコン単結晶化技術

慶應義塾大学理工学部機械工学科 関 紀旺

16:50～17:00 閉会挨拶

定員: 100 名

参加費: 2万円/人…会員:法人会員,協賛団体会員

4千円/人…学生会員

3万円/人…非会員

申込締切: 平成 24 年 11 月 2 日(金)

申込方法: レーザ協会事務局 HP からできます.

→ <http://jslt.jp/postmail-utf/postmail.html>

問い合わせ先: レーザ協会事務局 (<http://jslt.jp/>)